

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年8月10日(10.08.2023)



(10) 国際公開番号

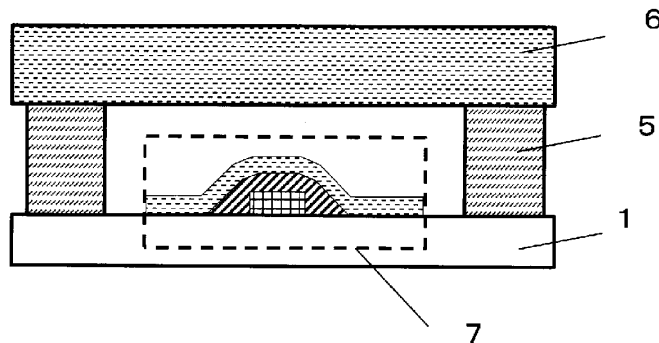
WO 2023/149398 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) H01L 21/768 (2006.01)
G03F 7/028 (2006.01) H01L 23/532 (2006.01)
G03F 7/037 (2006.01) H10N 30/80 (2023.01)
H01L 21/312 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2023/002867
- (22) 国際出願日: 2023年1月30日(30.01.2023)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2022-014663 2022年2月2日(02.02.2022) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小山 祐太郎(KOYAMA, Yutaro); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 荒木 斉(ARAKI, Hitoshi); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP,

(54) Title: LAMINATE, METHOD FOR MANUFACTURING LAMINATE, HOLLOW STRUCTURE, AND ELECTRONIC COMPONENT

(54) 発明の名称: 積層体、積層体の製造方法、中空構造体および電子部品

【図3】



(57) Abstract: Provided is a laminate with which there is little wiring corrosion during storage under high-temperature and high-humidity conditions. Provided is a laminate in which metal wiring (M1) having a thickness of 0.1 – 5 μm , a relief pattern of an organic insulating film (P1) having a thickness of 0.5 – 4 μm , and metal wiring (M2) having a thickness of 0.1–5 μm are formed in the order listed on a piezoelectric substrate, wherein the organic insulating film (P1) contains an alkali-soluble resin (A) and a cured product obtained by curing a photosensitive resin composition containing a naphthoquinonediazide compound (E), the naphthoquinonediazide compound (E) content is 5–25 parts by mass per 100 parts by mass of the alkali-soluble resin (A), and when the organic insulating film (P1) is measured using an ion elution amount measurement method, the ion elution amount is 2000 ppm or less.

[続葉有]

WO 2023/149398 A1

KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK,
LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX,
MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH,
PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG,
SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ,
UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 高温高湿条件下の保存時の配線腐食の少ない積層体を提供する。圧電体基板上に、厚さ0.1~5 μ mの金属配線(M1)と膜厚0.5~4 μ mの有機絶縁膜(P1)のレリーフパターンと厚さ0.1~5 μ mの金属配線(M2)がこの順に形成された積層体であって、該有機絶縁膜(P1)がアルカリ可溶性樹脂(A)と、ナフトキノンジアジド化合物(E)を含有する感光性樹脂組成物を硬化させて得られる硬化物を含有し、該アルカリ可溶性樹脂(A)100質量部に対し、該ナフトキノンジアジド化合物(E)の含有量が5~25質量部であり、イオン溶出量の測定方法で該有機絶縁膜(P1)を測定したときに、イオン溶出量が2000ppm以下である積層体。